

## 王春青

工学博士

电子封装技术专业 / 先进焊接与连接国家重点实验室  
教授;

材料科学与工程学科 博士生导师

电子科学与技术学科 博士生导师

+86-451-86418725

[wangcq@hit.edu.cn](mailto:wangcq@hit.edu.cn)

<http://eptech.hit.edu.cn>

### 主要研究方向

---

电子封装;

微连接与精密焊接;

半导体照明。

### 社会兼职

---

中国电子学会 电子制造与封装分会 常务理事

中国半导体行业协会 封装与测试分会 副理事长

### 主要学术成果

---

学术论文 [http://eptech.hit.edu.cn/EPTech/EPT\\_Thesis.html](http://eptech.hit.edu.cn/EPTech/EPT_Thesis.html)

1. Wufeng Feng, *Chunqing Wang* and M. Morinaga, Electronic structure mechanism for the wettability of Sn-based solder alloys, *Journal of Electronic Materials* Volume 31, Number 3, p185-190, 2002, 引用次数 19
2. Ying Ding, Chunqing Wang, Li Mingyub and Bang Han-Sura, Aging effects on fracture behavior of 63Sn37Pb eutectic solder during tensile tests under the SEM, *Materials Science and Engineering A*, Volume 384, Issues 1-2, 25 October 2004, p314-323, 引用次数 18

.....

发明专利 [http://eptech.hit.edu.cn/EPTech/EPT\\_Patents.asp](http://eptech.hit.edu.cn/EPTech/EPT_Patents.asp)

1. ZL 00129114.9 超声激光无钎剂软钎焊方法
2. ZL 200710144581.6 LED 芯片与热沉直接封装的散热组件及其制造设备和方法
3. ZL 200710144639.7 双束激光辅助 LED 芯片与热沉直接键合的方法

.....

研究生培养 [http://eptech.hit.edu.cn/EPTech/EPT\\_Students.asp](http://eptech.hit.edu.cn/EPTech/EPT_Students.asp)